

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2025年6月12日(12.06.2025)



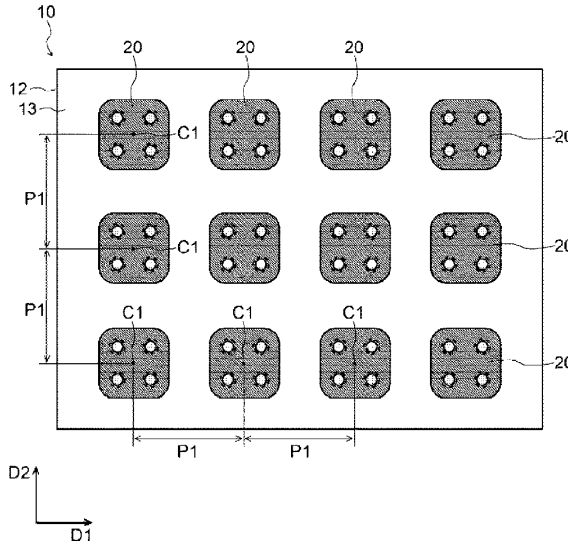
(10) 国際公開番号

WO 2025/121374 A1

- (51) 国際特許分類:
H05K 1/11 (2006.01) H05K 3/40 (2006.01)
H05K 1/02 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2024/043050
- (22) 国際出願日: 2024年12月5日(05.12.2024)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2023-205616 2023年12月5日(05.12.2023) JP
特願 2024-077561 2024年5月10日(10.05.2024) JP
- (71) 出願人: 大日本印刷株式会社 (DAI NIPPON PRINTING CO., LTD.) [JP/JP]; 〒1628001 東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号 (JP).
- (72) 発明者: 倉持 悟 (KURAMOCHI Satoru); 〒1628001 東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号 大日本印刷株式会社内 (JP). 田井貴裕 (TAI Takahiro); 〒1628001 東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号 大日本印刷株式会社内 (JP). 藤本 興治 (FUJIMOTO Koji); 〒1628001 東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号 大日本印刷株式会社内 (JP).
- (74) 代理人: 宮嶋 学, 外 (MIYAJIMA Manabu et al.); 〒1000005 東京都千代田区丸の内1

(54) Title: THROUGH-ELECTRODE SUBSTRATE AND METHOD FOR MANUFACTURING THROUGH-ELECTRODE SUBSTRATE

(54) 発明の名称: 貫通電極基板及び貫通電極基板の製造方法



(57) Abstract: This through electrode substrate includes: a substrate including a first surface, a second surface located on the opposite side of the first surface, and a plurality of through holes penetrating from the first surface to the second surface; and a plurality of through electrodes reaching the second surface from the first surface through the through holes. Each of the plurality of through electrodes includes a plurality of internal portions positioned inside the plurality of through holes, a first portion positioned on the first surface and connected to the plurality of internal portions, and a second portion

[続葉有]

丁目 6 番 6 号 日本生命丸の内ビル 協
和特許法律事務所 (JP).

- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告 (条約第21条(3))

positioned on the second surface and connected to the plurality of internal portions. The first portions of the plurality of through electrodes each have a contour surrounding the plurality of through holes in the plan view.

(57) 要約: 貫通電極基板は、第1面と、第1面の反対側に位置する第2面と、第1面から第2面へ貫通する複数の貫通孔と、を含む基板と、第1面から貫通孔を通して第2面へ達する複数の貫通電極と、を備える。複数の貫通電極はそれぞれ、複数の貫通孔の内部に位置する複数の内部部分と、第1面に位置し、複数の内部部分に接続されている第1部分と、第2面に位置し、複数の内部部分に接続されている第2部分と、を含む。複数の貫通電極の第1部分はそれぞれ、平面視において複数の貫通孔を囲む輪郭を有する。